

Предложены клеевое соединение и чип-карточка, изготовленная с помощью клеевого соединения. Клеевое соединение клеевым слоем (V) соединяет деталь (1) из первого материала с пластмассовой деталью (5), причем клеевой слой (V) имеет многослойную структуру и состоит из эластичного основного слоя (4), изготовленного из акрилата, и прилегающих к первой детали (1) и пластмассовой детали (5) приповерхностных слоев (2), изготовленных из клея горячего отвердевания. Между каждым приповерхностным слоем (2) и основным слоем (4) расположены переходные слои (3). Чип-карточка состоит из полупроводникового модуля и корпуса карточки, соединенных между собой предложенным клеевым соединением.